

Er:YAGレーザー アドベールSH



Adverl SH



Thinking ahead. Focused on life.

Adverl SH

進化した「やさしい治療」

Er:YAGレーザーは、水を含んだ生体組織に対する蒸散能力が高く、表層にのみ反応が起こり、熱の発生が微小なため、痛みが少ないという特徴を持つ、人にやさしいレーザーです。アドベールSHは治療に必要な機能をコンパクトなボディに集約したEr:YAGレーザー装置です。高パルス、高出力に加え、治療をナビゲートするプリセットモードで、さまざまな治療シーンに対応できます。

保険収載項目 2024年4月現在

う蝕歯無痛の窩洞形成加算	40点
手術時歯根面レーザー応用加算	60点
口腔粘膜処置（1口腔につき）	30点
レーザー機器加算1	50点
レーザー機器加算2	100点
レーザー機器加算3	200点





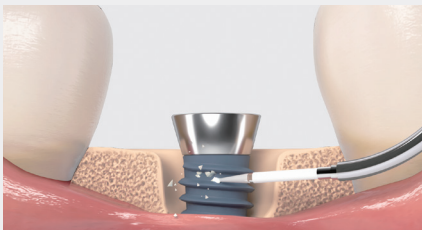
プロモーションビデオ

Wide Variety of Treatments

さまざまな治療シーンに

承認された多くの使用目的と効果

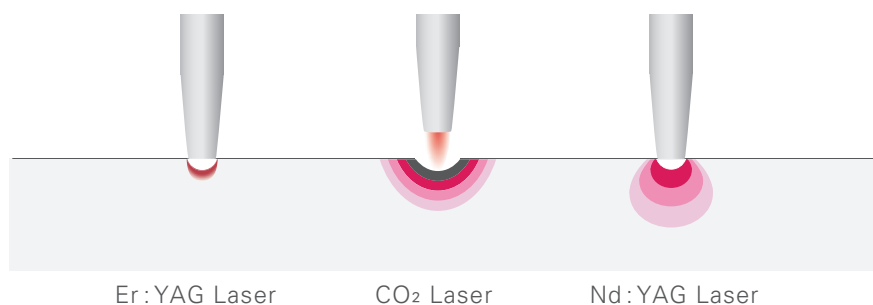
Er:YAGレーザーは硬組織疾患、歯周疾患、軟組織疾患のさまざまな使用目的と効果が薬機法上の承認を受けています。アドベールSHは幅広い症例のプリセットから選択するだけで必要なコンタクトチップ、出力設定を呼び出すことができます。高パルス化、出力範囲の拡大で、低侵襲かつ処置効率の高い照射が可能です。またさまざまな治療シーンに対応できる多彩なコンタクトチップとフレキシブルな操作性が患者さん、術者の負担をやわらげ、効率的なレーザー治療を実現します。

硬組織疾患	歯周疾患	軟組織疾患
効果: 蒸散	効果: 切開、蒸散	効果: 切開、止血、凝固、蒸散
う蝕除去 くさび状欠損の表層除去	歯石除去（インプラントへの付着を含む）* 骨切除** 歯周ポケットへの照射 ポケット搔爬 フラップ手術 歯肉整形	歯肉切開・切除 口内炎の凝固層形成 小帯切除 色素沈着除去
		
う蝕除去	歯石除去（インプラントへの付着を含む）	歯肉切開・切除

*インプラント周囲炎の治療過程において、インプラントに付着した歯石の除去が可能です。 **骨形成、デコルケーション等における骨の切開・蒸散が可能です。

生体組織に負担の少ない治療

Er:YAGレーザーは、光エネルギーの吸収が表層に限定されて行われるため、CO₂レーザー、Nd:YAGレーザーに比べ、透過光による組織深部への影響が少なくてすみます。またエナメル質にクラックが起こりにくく、照射野周囲の熱拡散が少ないため、周囲組織への影響はほとんどありません。

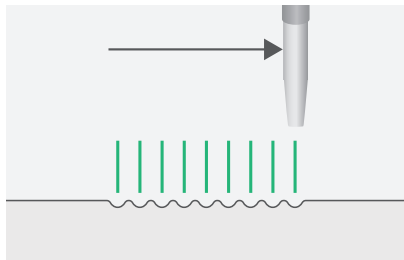


Improving Treatment Efficiency

高パルス、高出力による治療効率向上

患者さん、術者双方にやさしい治療を

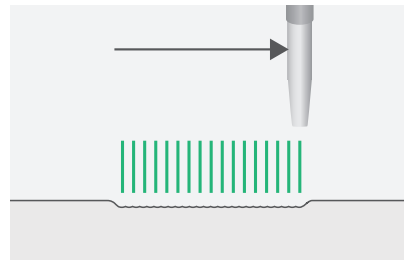
高パルス化に加え、低出力から高出力まで出力範囲が拡大したことで、効率アップによるスピーディーな治療が可能になりました。治療時間の短縮・操作性向上による手技の簡易化で、患者さんと術者双方の負担を減らします。



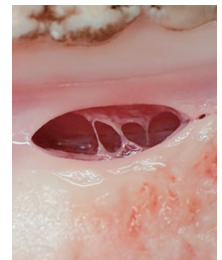
低パルス



軟組織切開
20pps 50mJ



高パルス



軟組織切開
40pps 50mJ

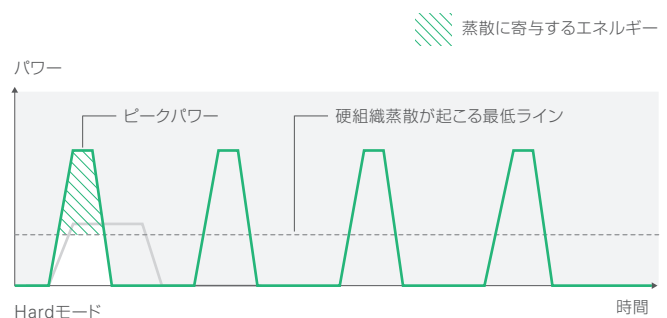
Hardモード、Softモードの2モードを搭載

同じエネルギー量でもパルス幅とピークパワーが異なる2つのモードを搭載しました。それぞれのパルス特性を生かした、各症例や部位に適した照射が可能です。

Hardモード

ピークパワー 高
パルス幅 短

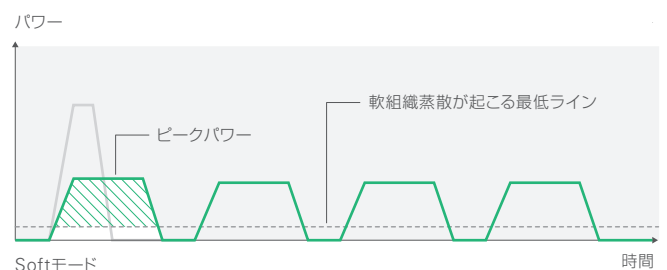
使用例：う蝕除去（エナメル質）、骨整形



Softモード

ピークパワー 低
パルス幅 長

使用例：歯肉切開・切除、止血





スマート&コンパクト

スマートデザイン、コンパクトで軽量な本体は、院内に馴染むデザインです。

Easy Navigation

18種類の症例が選択可能なプリセットモードによる簡単ナビゲーション

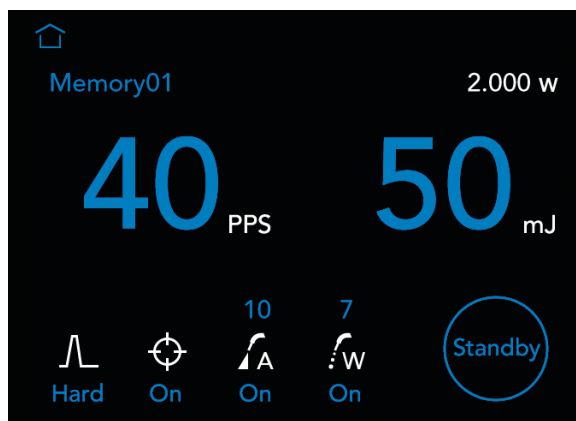
便利なプリセットモード

治療内容に合わせたプリセットを選択するだけで、症例に応じて設定された条件やコンタクトチップが表示され、簡単に使用出来るようナビゲートします。



マニュアルモード

条件を手動で設定できるモードです。任意の条件をメモリーに記憶させ、必要なときに呼び出して使用することも可能です。



直感的でわかりやすいインターフェース

各設定がひと目で把握できる分かりやすいディスプレイは、各設定画面へも直感的にアクセスできます。

プリセットモード使用フロー



プリセットモード画面(一部)

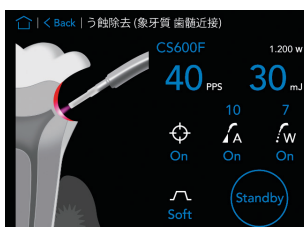
硬組織疾患



う蝕除去(エナメル質)



う蝕除去(象牙質)



う蝕除去(象牙質 歯髄近接)

う蝕除去(エナメル質)
う蝕除去(象牙質)
う蝕除去(象牙質 歯髄近接)
露髄止血

歯周疾患



歯周ポケット照射



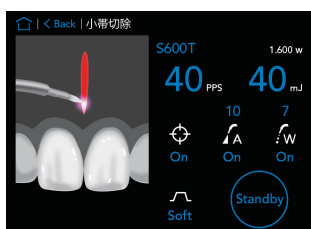
歯石除去



不良肉芽除去

歯周ポケット照射
歯石除去
不良肉芽除去
骨整形
デコルチケーション

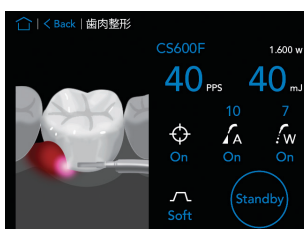
軟組織疾患



小帯切除



歯肉切開・切除



歯肉整形

小帯切除
歯肉切開・切除
歯肉整形
メラニン除去
メタルタトゥー除去
口内炎・口角炎凝固
止血

インプラント



インプラント表面歯石除去



インプラント表面不良肉芽除去

インプラント表面歯石除去
インプラント表面不良肉芽除去

Clinical Cases

臨床への応用例

Case 1 歯周外科治療



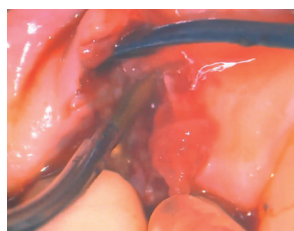
術前



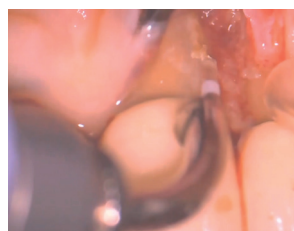
術後（1年後）



術前



不良肉芽除去



歯石除去（保険収載）



術後（1年後）

術前の歯周ポケット深さは10mm、排膿があり、最小侵襲のフラップ手術をマイクロサージェリーで行った。

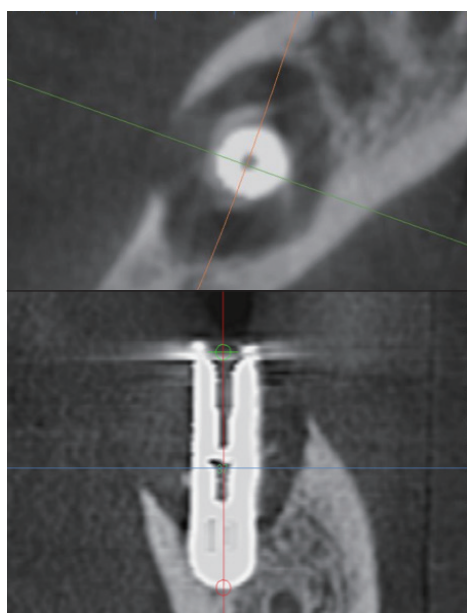


骨欠損内の肉芽組織、歯根面の歯石を蒸散した。歯周組織再生材は用いず、弁の復位、縫合を行った。
術後1年のエックス線写真では骨欠損の回復を認めた。

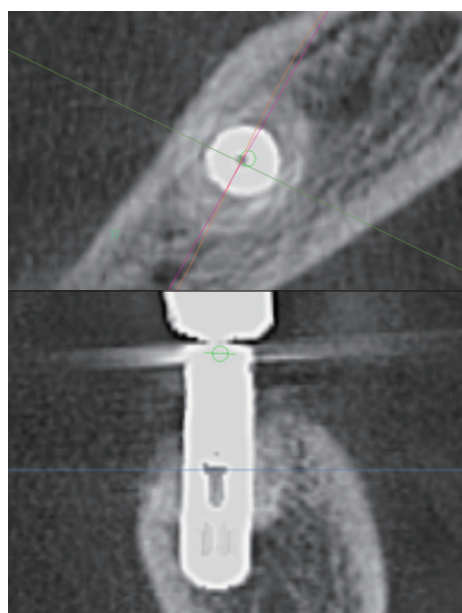


臨床動画

Case 2 インプラント治療

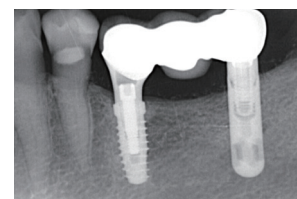


術前

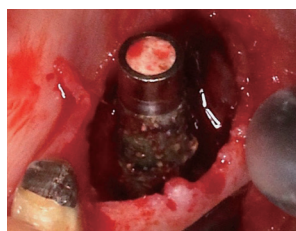


術後（2年半後）

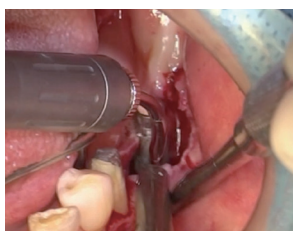
左：術前
広範囲に骨吸収像が観察され、
通常保存不可と判断される
場合が多い。
中央：術後（2年半後）
周囲は骨様組織で覆われている。
下：術後（9年後）
再吸収像などなく安定して
骨様像が観察されている。



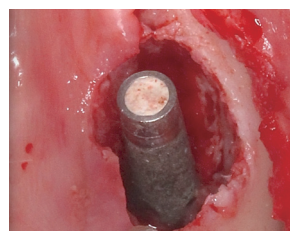
術後（9年後）



術前



歯石除去

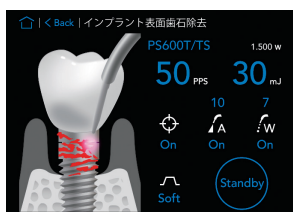


術後



術後（2年半後）

インプラント周囲には歯石が
強固に付着している。この
ような場合インプラント表面
の微細構造を破壊せず歯石
を除去するのは困難である。



インプラント表面の歯石を丁寧
に除去する。

除去後のインプラント表面は
歯石などの感染物質が綺麗に
除去されている。

周囲は骨様組織で覆われて
いる。

Clinical Cases

臨床への応用例

Case 3 う蝕除去 象牙質 (保険収載)



術前



術中



蒸散後

40ppsで蒸散することによって、50mJという低エネルギーでも、この症例のようなカリエスなら約20秒ほどで無麻酔で無痛蒸散ができる。このことは従来のように麻酔をして効果が発揮するのを待つ時間で全てが完了するというメリットがある。

Case 4 う蝕除去 エナメル質・象牙質 (保険収載)



術前



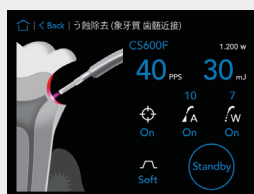
術中



術後

従来器種よりも高出力（180mJ）でのエナメル質蒸散を行い、次に象牙質での高パルス（40pps）の効率良い蒸散を行った。無麻酔下で患者は疼痛を訴えなかった。

Case 5 露髄面への照射



術前



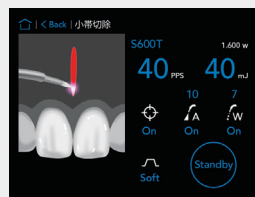
術中



術後

深部カリエス処置時の偶発的露髄面は細菌が侵入している可能性があり、表層を蒸散する事により感染をコントロールできる可能性がある。

Case 6 小帯切除(保険収載)



術前



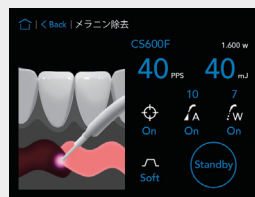
術中



術後(1週間後)

頬小帯により口腔前庭が狭小となっているため切除を行った。局所麻酔下でS600Tを用いて切除し、顎堤側に残存している線維束の断端をCS600Fで蒸散した。その後、創面の出血を非注水のdefocus照射で止血した。1週間後に創面は上皮化し、良好な治癒を示している。

Case 7 メラニン除去



術前



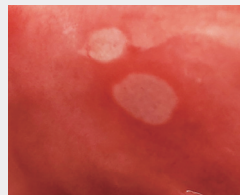
術直後



術後(2週間後)

メラニン色素沈着のある歯肉表層をCS600Fで注水下で蒸散する。残存した深部の色素沈着を選択的にC400Fで蒸散して仕上げる。1週間後に創面は上皮化し、歯肉の色調改善が得られている。

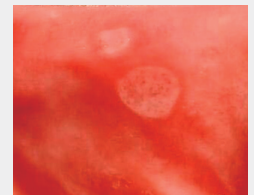
Case 8 口内炎、口角炎凝固 (保険収載)



術前



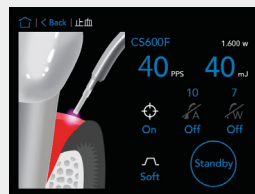
術中



術後(1日後)

Softモードを用い臨床に応用した。従来器種で広域患部を照射するのに比べて短時間にて有効で、Softモードが使用できることにより従来の照射法より患者が訴える痛みの減少がみられた。

Case 9 止血



術前



術中



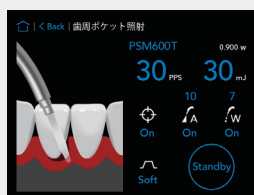
術後

歯周ポケット治療後のポケット入り口の出血部に対し、無注水の非接触照射で3-5mm程度の照射距離を保ち、スポットサイズを拡大させ、スウィーピングモーションにて表面が軽く炭化する程度まで全体的に均等に照射を行う。

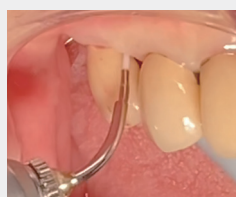
Clinical Cases

臨床への応用例

Case 10 歯周ポケット照射



術前



術中



術後(1か月後)

歯周ポケット治療のため、注水下においてポケット内照射を行う。根面、ポケット底部、ポケット内壁など、ポケット内全体を丁寧に照射し、主に炎症性肉芽組織を掻爬する。術後には順調で良好な治癒が認められた。

Case 11 歯石除去



術前



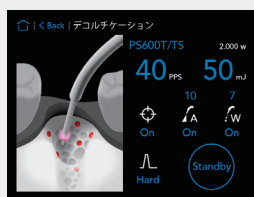
術中



術後(2週間後)

術前の歯周ポケット深さは5mm、出血を認めた。局所麻酔下で歯周ポケット内にチップを歯根面に沿って挿入し、粗造感のある根面のデブリッドメントをおこなった。蒸散された歯肉縁下歯石が排出されている。術後に歯周ポケットは2mmとなり、安定している。

Case 12 デコルチケーション



術前



術中



術後

歯周組織再生治療において、骨欠損部の掻爬後に認められた皮質骨化した骨面に対し、組織再生に有利となるよう、注水下でニアコンタクトでの定点照射により、骨髓穿孔を行い、骨髓からの出血を促す。骨組織は、重篤な熱傷害はなく比較的容易に蒸散される。

症例画像・解説提供 (50音順)

青木章先生	東京医科歯科大学大学院	Case 9, 10, 12
篠木毅先生	篠木歯科	Case 4, 8
鳥潟隆睦先生	りゅうぼく歯科	Case 2
松本邦夫先生	松本歯科医院	Case 5
水谷幸嗣先生	東京医科歯科大学病院 歯周病科	Case 1, 6, 7, 11
山本敦彦先生	医療法人成仁会 藤沢台山本歯科	Case 2, 3

Case 3, 4, 8 アドベールSH使用症例

その他 従来器種 アーウィン アドベールEVO 使用症例

提供いただいた症例とプリセットモードの出力設定は異なる場合がございます。
解説は症例提供元の先生よりいただきました。画像は提供いただいた医院様での一例です。

Smooth Handling

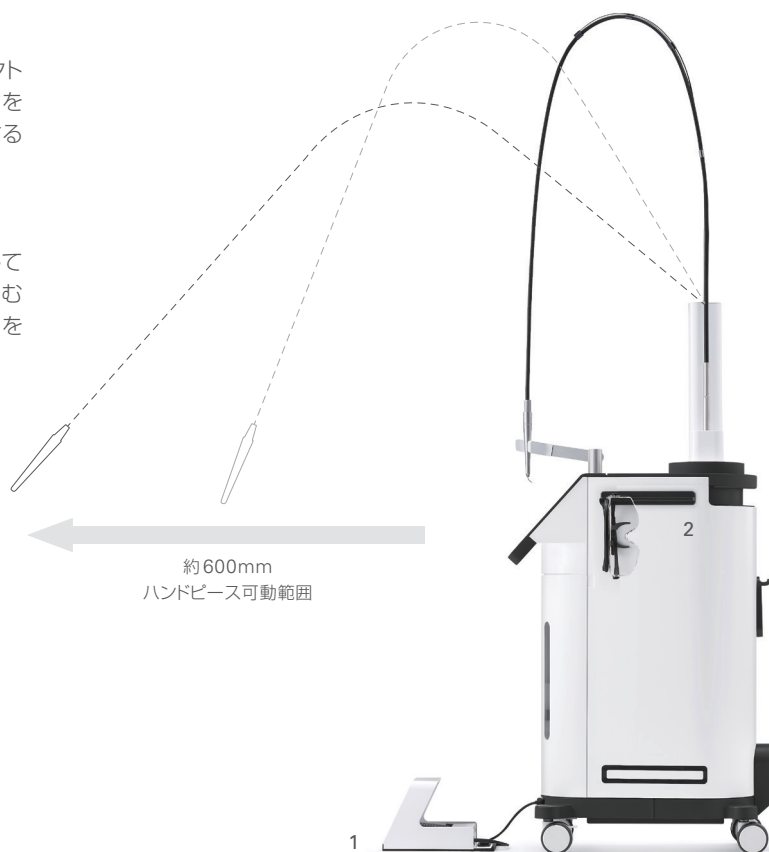
ストレスのない操作

フレキシブルな操作性

フレキシブルな伝送ファイバーとプロテクトポールにより、手先にハンドピースの重さをほとんど感じさせないため、治療に集中することができます。

イーザーセッティング

水、エアーコンプレッサーを本体に内蔵しているため、コンセントにプラグを差し込むだけで使用可能です。都度エアーや水を接続する必要がありません。



1. フットスイッチ（コード長 約800mm）
2. メガネハンガー



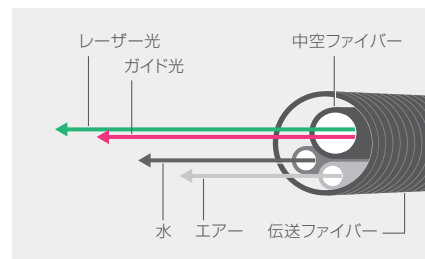
位置調整が可能なハンガー

診療時や移動時など、シーンに応じてハンドピースのハンガー位置を変えることが出来ます。ハンドピースはハンガーに内蔵のマグネットでホールドされ、移動時などの振動による落下を防ぎます。



4輪自在キャスターでスムーズに装置移動

どの方向にも動かしやすく小回りが利く4輪自在キャスターを採用しました。準備や片付け時の装置移動のストレスを軽減します。



伝送ファイバー構造

中空ファイバーによって、広い波長域と高い伝送効率を実現、レーザー光、ガイド光を同軸上に伝送することが可能です。レーザー光とガイド光の位置にずれがないため、精密な治療に貢献します。



使い方動画

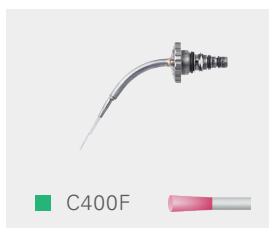
Tip Lineup

コンタクトチップラインナップ

合計 15 種のチップにより、多くの臨床に対応。

■ 印のあるチップは本体付属品です。それ以外のチップはオプションです。

■ 印のあるチップにはオプションの R アタッチメントが必要です。



C400F



C400FL



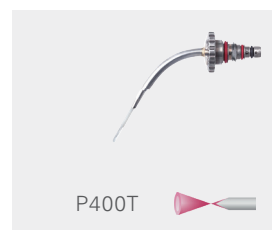
C600F



C800F



CS600F



P400T



PS400T



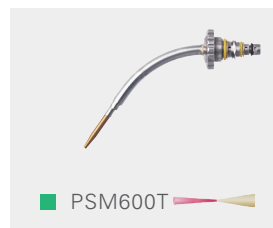
PS400TS



PS600T



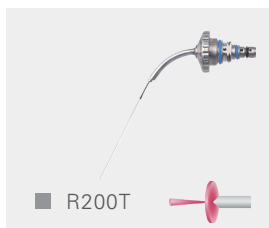
PS600TS



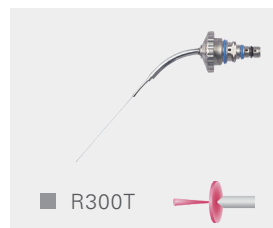
PSM600T



S600T



R200T



R300T



R600T



製品紹介ページ

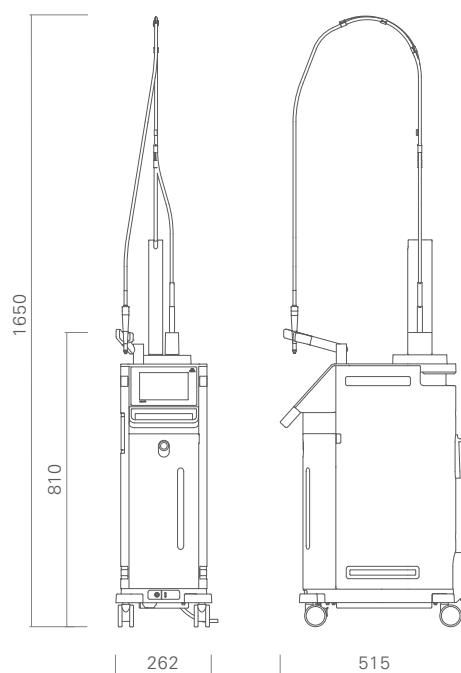
Specifications

製品仕様

販売名：アドベールSH
型式：MEY-1-SH
電源電圧：AC100V
定格電源入力：1.0 kVA
質量：38kg
一般的名称：エルビウム・ヤグレーザ
医療機器分類：高度管理医療機器（クラスⅢ）特定保守管理医療機器
承認番号：30500BZX00080000
法定耐用年数（償却年数）：6年
製造販売：株式会社モリタ製作所

電撃に対する保護：クラスⅠ機器 B形装着部
レーザー製品のクラス分け：クラス4（Er:YAGレーザー）、クラス2（可視LD（ガイド光））
レーザーの発振方式：パルス発振
レーザー媒質：Er:YAG
レーザー光の出力エネルギー：10～400mJ/パルス（ハンドピース先端）
1～10pps：30～400mJ/パルス 20pps：15～200mJ/パルス
25pps：15～160mJ/パルス 30pps：10～100mJ/パルス
40pps：10～70mJ/パルス 50pps：10～40mJ/パルス
繰返し速度：1, 3.3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50pps
発振波長：2.94μm
ガイド光：赤色半導体レーザー光
ガイド光波長：650±15nm
伝送方式：中空ファイバー方式

販売名：レザチップ
型式：MEY-C
一般的名称：レーザー用コンタクトチップ
医療機器分類：高度管理医療機器（クラスⅢ）
承認番号：21500BZZ00721000
製造販売：株式会社モリタ製作所



外観寸法図（mm）

Industrial Design: f/p design

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター（歯科医療従事者様専用） T 0800. 222 8020（フリーコール）

株式会社 モリタ製作所

本社 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 T 075. 611 2141

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
このカタログに記載されている社名又は商品名は(株)モリタ、(株)モリタ製作所の保有する商標又は登録商標です。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。
写真には一部オプション装備が含まれています。

